



ISC IR BOOK

GLOBAL INNOVATION
ISC 

Disclaimer

본 자료는 투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 주식회사 아이에스시(이하 "회사")에 의해 작성되었습니다.

본 자료는 오로지 잠재적 투자자들에게 정보를 제공하기 위한 목적으로 작성되었으며, 투자권유사항을 포함하고 있지 않습니다.

이 자료에 포함된 예측정보는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 "예상", "전망", "계획", "기대" 등과 같은 단어를 포함합니다.

Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며, 현재 시장 상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 외부의 환경변화 혹은 회사의 경영전략 수정에 따라 별도의 고지없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 혹은 근거가 될 수 없으며, 본 자료의 활용과 관련하여 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 과실 및 기타의 경우를 포함하여 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.

또한, 본 자료를 무단으로 배포하여서는 아니 되며, 회사의 사전 승인없이 내용이 변경된 자료의 무단 배포 및 복제는 법적인 제재를 받을 수 있음을 유념해 주시기 바랍니다.

의문점이나 요청사항이 있을 경우, 아래의 정보를 이용하면 신속한 답변을 받을 수 있습니다.

☎ISC IR 팀 031-777-7675(146) sanghlee@isc21.kr

Contents

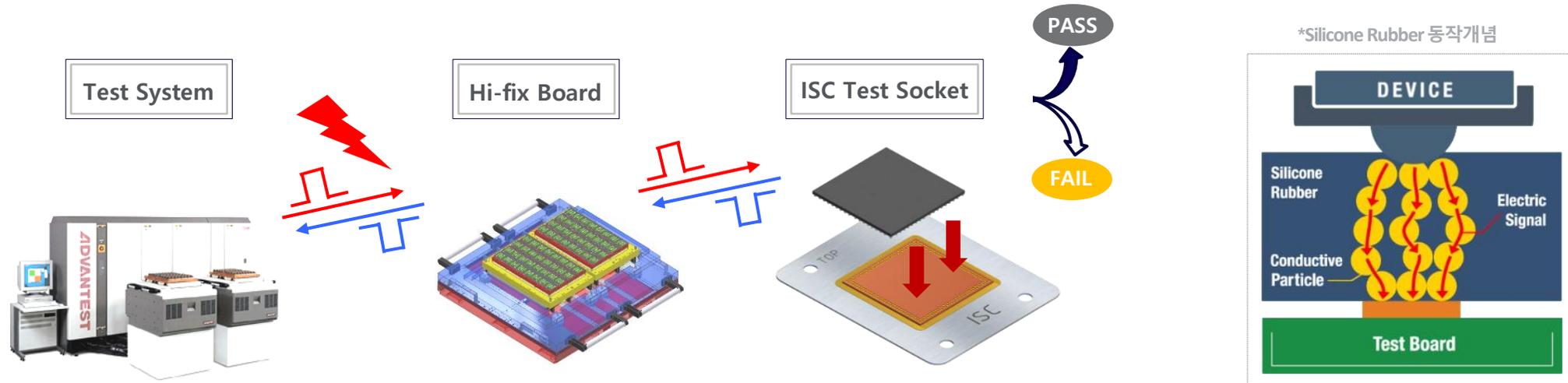
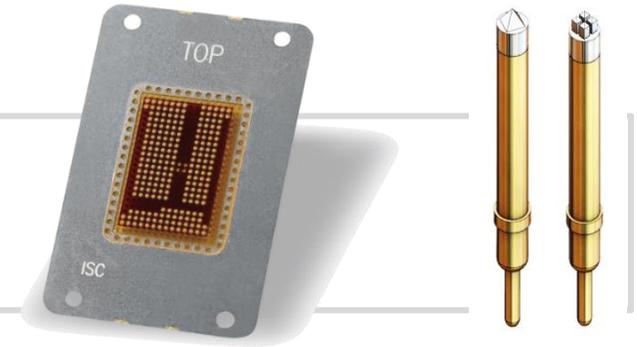
1. 회사 소개
2. 사업 개요
3. 핵심 경쟁력
4. 경영실적

1. 회사 소개 Test Socket

반도체 IC의 양품/불량 여부를 판단하는 전기적 성능 검사 시, 검사 설비와 반도체 Device를 연결하는 소모성 부품으로, 신규 디바이스 개발 시 동반 개발이 필수적이며, 다품종 소량 생산이 특징

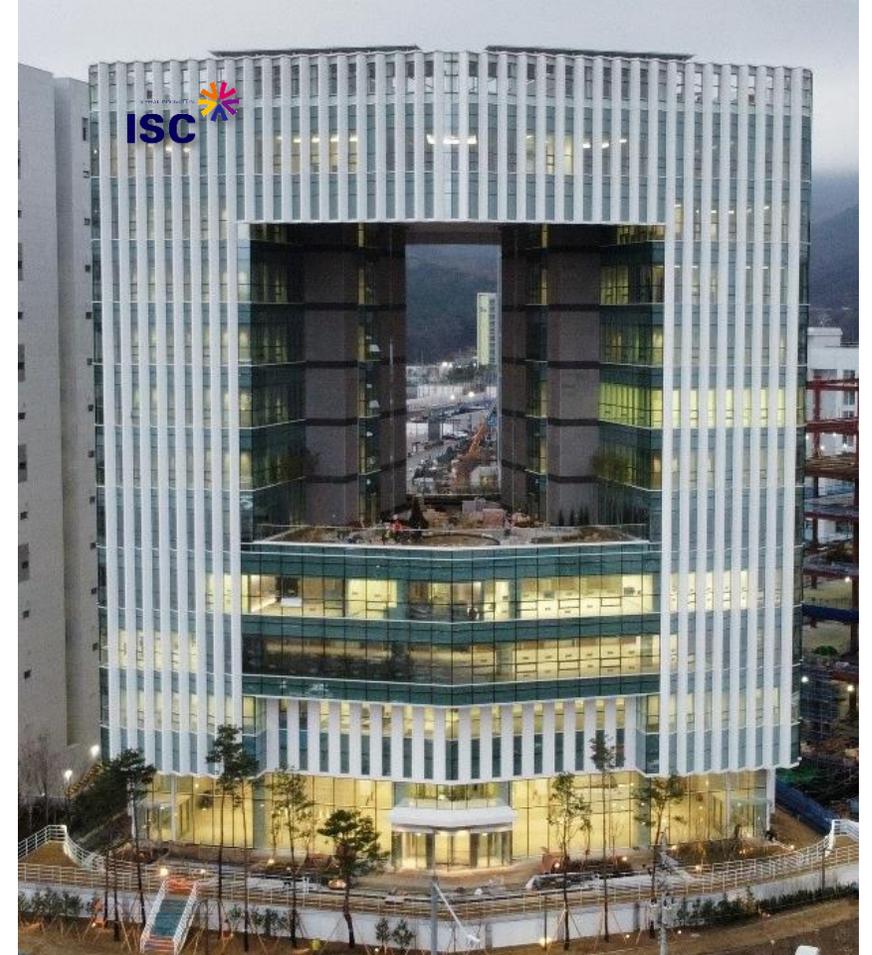
■ Silicone Rubber Test Socket

Silicone Rubber Test Socket은 ISC가 **국내 최초 개발, 세계 최초로 양산**에 성공한 제품으로, 기존 Pogo Pin 제품 대비 **Quality, Cost, Delivery** 경쟁력이 우수



1. 회사 소개 회사 개요

회사명	주식회사 아이에스시 (ISC Co., Ltd.)
대표이사	김정렬, 김종우
설립일	2001.02.22
매출액	1,789억원('22년 연결기준)
영업이익(율)	558억원(31.2%)
자본금	83억원
임직원수	1,183명(본사 218명, 자회사 965명) (23.05.01기준)
핵심사업	반도체 테스트 소켓을 비롯한 Total Test Solution 제공
홈페이지	https://kor.isc21.kr/main/
사업장	ISC / ITMTC (성남), ISC VN(베트남), ISCM(안성), PROWELL(안산) ISC International(미국), SMATECH(일본)



1. 회사 소개 회사 연혁

2001 – 2013: 설립 및 코스닥 상장

2001	<ul style="list-style-type: none"> ISC Technology 설립 국내 최초 실리콘 러버형 소켓 개발
2003	<ul style="list-style-type: none"> 세계 최초 실리콘 러버형 소켓 양산화 삼성전자, 하이닉스와 공급계약 체결
2005	<ul style="list-style-type: none"> 벤처기업대상 산업부장관상 수상
2007	<ul style="list-style-type: none"> 코스닥 시장 상장
2009	<ul style="list-style-type: none"> 인텔, 퀄컴, 애플 등의 비메모리업체 고객사 확보
2012	<ul style="list-style-type: none"> (주)아이에스시로 사명 전환 내구성 높은 Ni-Co 컨택터 신기술(NeT) 인증 획득

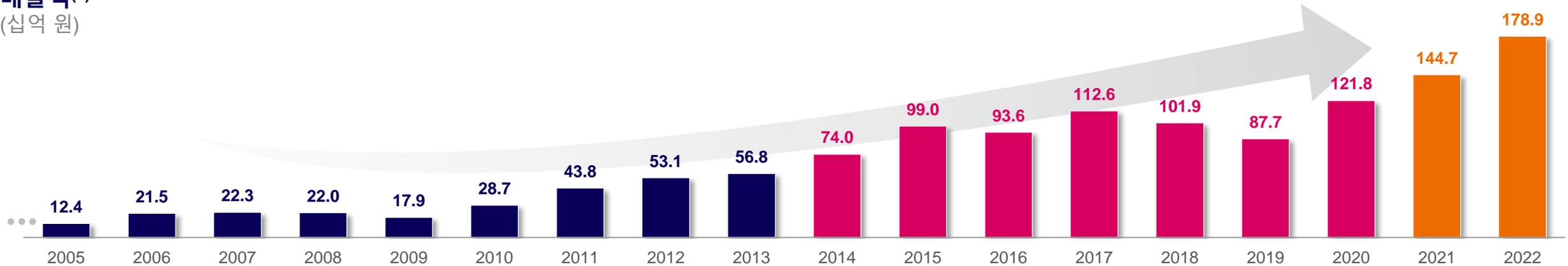
2014 – 2020: 러버소켓 매출 본격화

2014	<ul style="list-style-type: none"> 실리콘 러버형 소켓 2위 업체인 일본의 JMT 인수
2015	<ul style="list-style-type: none"> 글로벌 테스트 소켓 시장 점유율 1위 달성 (~현재)
2017	<ul style="list-style-type: none"> 베트남 생산법인 ISC VINA MANUFACTURING 설립 실리콘 러버형 소켓 세계일류상품 인증 획득
2018	<ul style="list-style-type: none"> 반도체 번인테스트용 러버소켓 출시 제 55회 무역의 날 7,000만불 수출의 탑 수상 다층구조의 MEMS 신기술(NeT) 인증 획득
2019	<ul style="list-style-type: none"> JMT 티에프이에 매각 벤처 1,000억 기업 선정
2020	<ul style="list-style-type: none"> ISCM 법인 설립 및 테스트보드 사업 런칭 베트남 공장 증설

2021 – 현재: 기술 고도화 및 인접영역 확장

2021	<ul style="list-style-type: none"> 지엠스 흡수합병 소켓 제조부문 물적분할 후 ITMTC 설립 최대주주 변경 (헬리오스 컨소시엄) 세계 최초 대면적 패키지용 러버 소켓 출시
2022	<ul style="list-style-type: none"> 포고핀 전문기업 프로웰 인수 업계 최초 3D 패키징용 러버 소켓 출시 5G 고주파·초미세 반도체용 실리콘 러버 소켓 출시 나노스피어 소재 적용 포고타입 RF 소켓 출시 5G 고주파안테나용 FCCL 출시
2023	<ul style="list-style-type: none"> 차세대 D램 소켓 출시 SKC 피인수

매출액(1)
(십억 원)



출처: 회사 자료.
비고: (1) 연결 재무제표 기준.

1. 회사 소개 관계사 현황

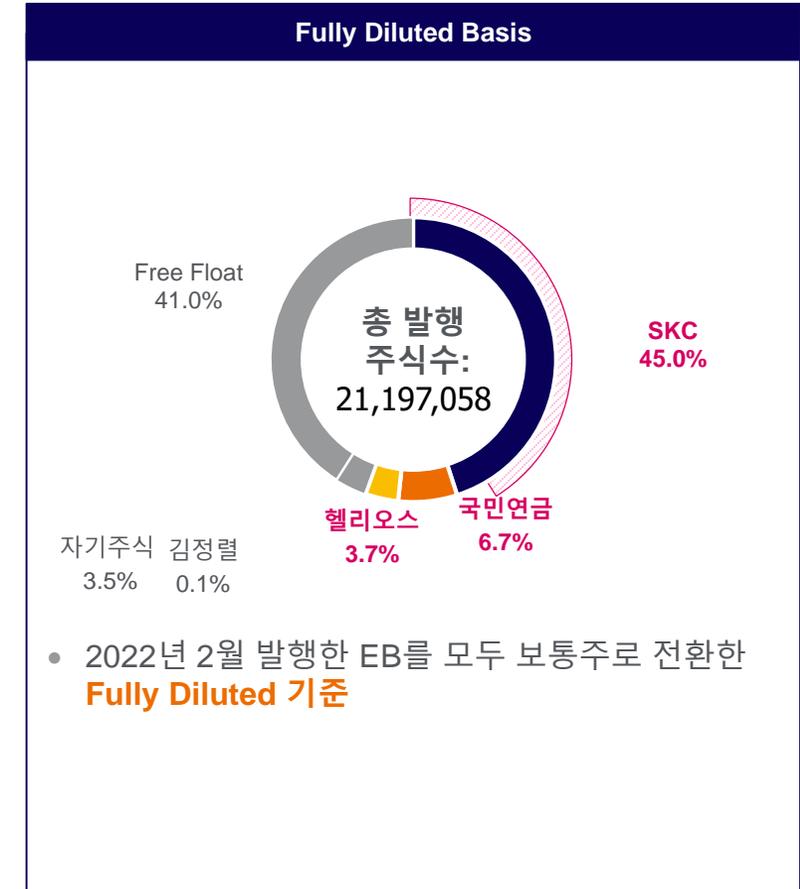
ISC는 R&D 및 영업에 집중하며 자회사를 통해 제조를 진행하고 있습니다

ISC 및 종속기업 현황 (2023년 12월 31일 기준)



ISC 주주구성

(2024년 12월 31일 기준)



1. 회사 소개 주요 생산 시설



국내 생산시설

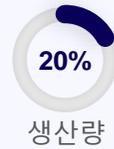


성남 공장



안산 공장

국내 총 면적:
ITMTC: 1,272 m²
프로웰: 1,932 m²



회사 (지역)	<ul style="list-style-type: none"> ITMTC (성남시 중원구) 프로웰 (안산시 단원구)
완공일	<ul style="list-style-type: none"> 2008년 5월 2015년 7월
생산제품	<ul style="list-style-type: none"> 실리콘 러버 / 번인 소켓 포고핀 / 포고소켓
생산비중	<ul style="list-style-type: none"> 전체 생산량의 25%
Key Highlights	<ul style="list-style-type: none"> 고가의 R&D 중심 High-end 제품 위주 테스트 샘플 등 단납기 대응 20년 이상의 운영 노하우를 바탕으로 높고 안정적인 수출 유지



베트남 생산시설



베트남 하노이 공장

베트남 총 면적:
19,909 m²



지역 (회사)	<ul style="list-style-type: none"> ISC VINA MANUFACTURING (베트남 하노이)
완공일	<ul style="list-style-type: none"> 2017년 10월
생산제품	<ul style="list-style-type: none"> 실리콘 러버 / 포고 소켓 / 소켓 원재료 등
생산비중	<ul style="list-style-type: none"> 전체 생산량의 75%
Key Highlights	<ul style="list-style-type: none"> 중저가 및 양산 제품 위주로 Low-end 제품 대량 생산 가능 가격 경쟁력 우수 비교적 노동력이 많이 투입되는 포고 소켓 및 소켓 원재료 생산

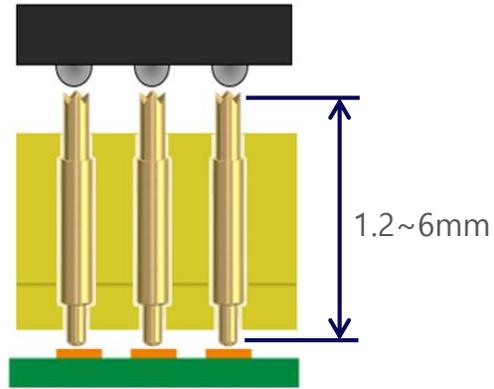
2. 사업개요 Market Share

- **Silicone Rubber Test Socket 압도적 세계 1위 (규모 180M\$, M/S 75%)**
- Overall Test & B/I Market Share 세계 3위 (규모 1,873M\$, M/S 6.9%)
- Test Socket 분야 세계 4위 (규모1,342M\$, M/S 8.7%)
- B/I Socket 분야 세계 9위 (규모 531M\$, M/S 2.4%)

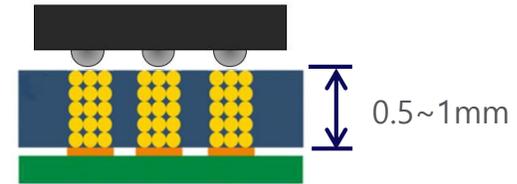
Rank	Overall	Test Socket	B/I Socket	Rubber Socket ⁽¹⁾
1	Yamaichi(9.9%)	Cohu(9.7%)	Yamaichi(17.9%)	ISC(75%)
2	Cohu(6.9%)	Yokowo(9.6%)	Sensata(17.9%)	TSE(10%)
3	ISC(6.9%)	Leeno(9.4%)	Enplas(14.6%)	JMT(10%)
4	Yokowo(6.9%)	ISC(8.7%)	MCS(6.3%)	Others(5%)
5	Leeno(6.9%)	Winway(7.1%)	Plastronics(4.7%)	
6	Enplas(6.8%)	Yamaichi(6.8%)	Okins(4.3%)	
7	Winway(6.2%)	Advantest(6.0%)	Loranger(3.8%)	
8	Sensata(5.7%)	Smith(5.4%)	3M(2.8%)	
9	Advantest(5.1%)	Enplas(5.3%)	ISC(2.4%)	
10	Smith(4.3%)	TSE(2.9%)	KZT(2.3%)	
	Others(34.5%)	Others(29.1%)	Others(23.0%)	
Market Size	US\$1,873M (2.3조원 YoY 6.2%)	US\$1,342M (1.6조원 YoY 6.7%)	US\$531M (6,372억원 YoY 5.0%)	US\$180M (2,160억원 YoY 6.7%)

2. 사업개요 실리콘러버소켓의 장점 : High Speed, Solder-ball Protection

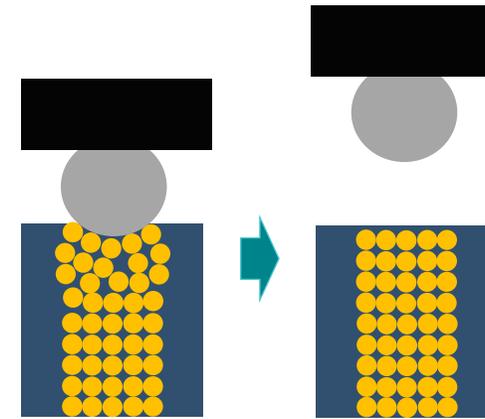
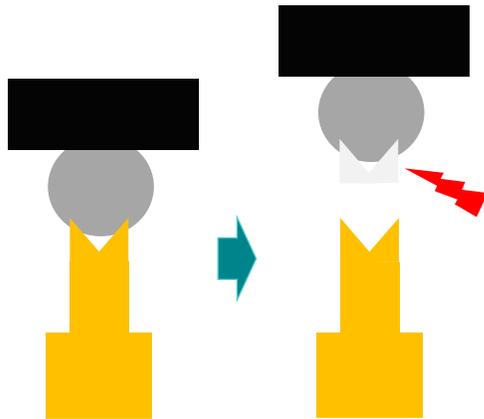
[Pogo Socket]



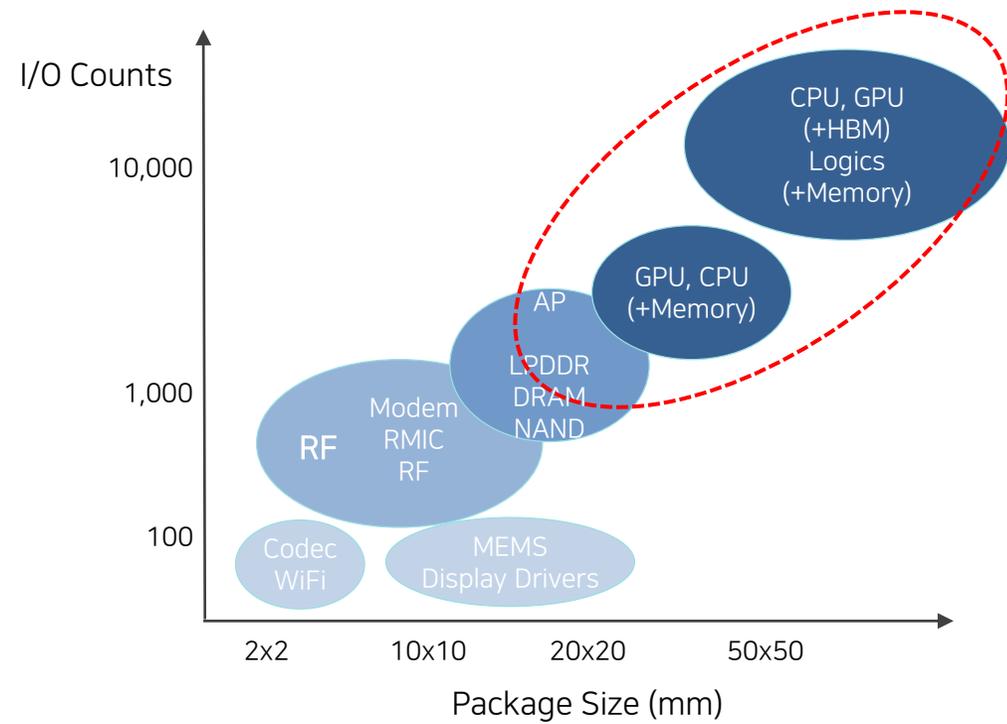
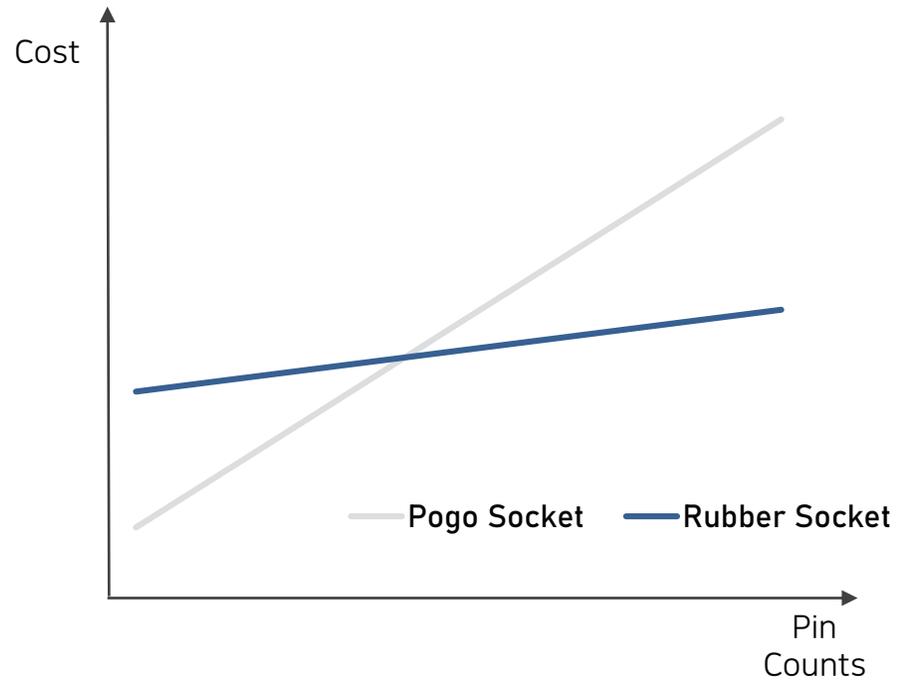
[Rubber Socket]



VS



2. 사업개요 실리콘러버소켓의 장점 : Low Cost

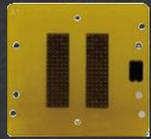


3. ISC 경쟁력 Game Changer

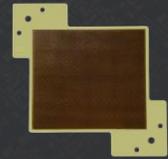


러버 테스트 소켓 시장을 개척한
독보적인 1위 업체이자 시장 개척자

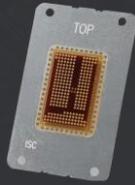
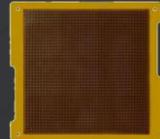
러버 테스트 소켓 제품군



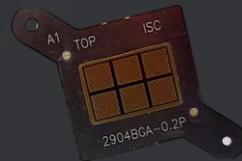
iSC-5G



iSC-WIDER



iSC-N5



iSC-N5

No.1

러버 테스트
소켓 제조사

No.4

전체 테스트
소켓 제조사

1st

세계 최초 러버
소켓 양산화 (2003)

1st

세계 최초 비메모리향
러버 소켓 양산화 (2011)

~70%

High-End 시장인 DDR5
시장 내 ISC 시장점유율

300+

글로벌 블루칩 고객군

3. ISC 경쟁력 테스트소켓 산업의 패러다임 전환

ISC의 실리콘 러버 테스트 소켓 개발 및 양산 관련 주요 연혁

- 메모리향
- 비메모리향

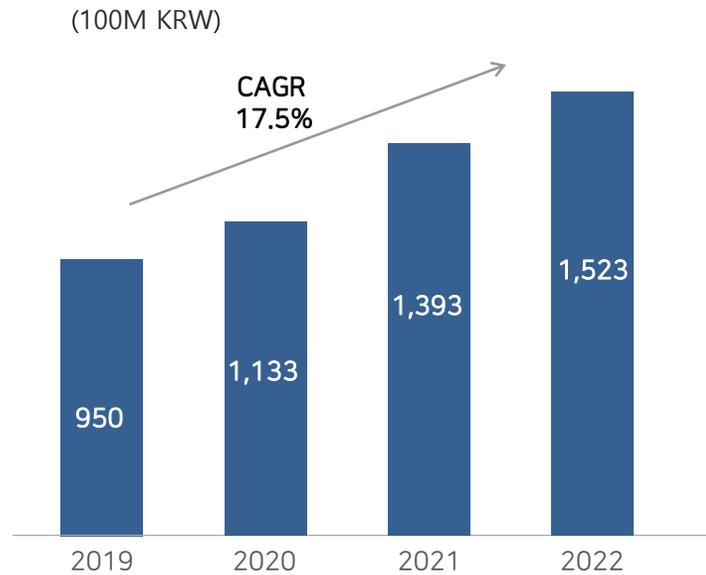


출처: 회사 자료.
주석: (1) 고내구성 Ni-Co 컨택터 기술.

3. ISC 경쟁력 러버소켓의 비메모리 매출 증가

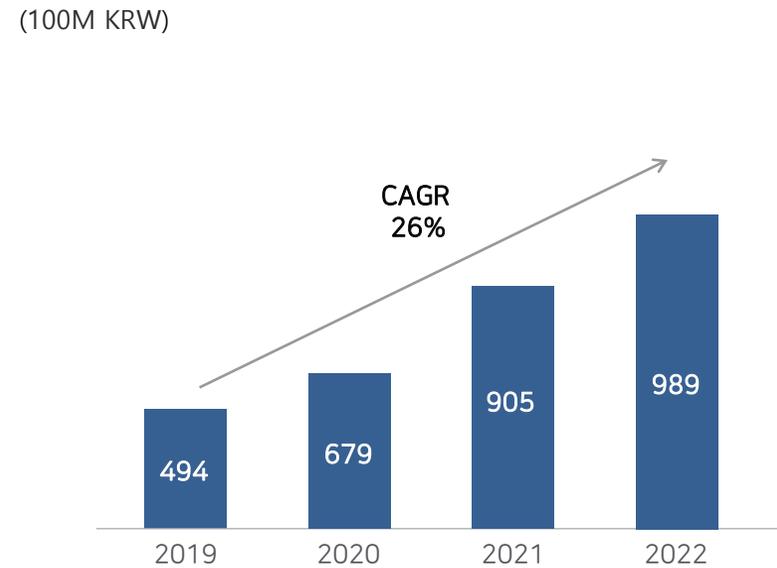
[2019~2022 Rubber Socket Sales]

“전체 매출의 80%는 러버소켓에서 발생 ”



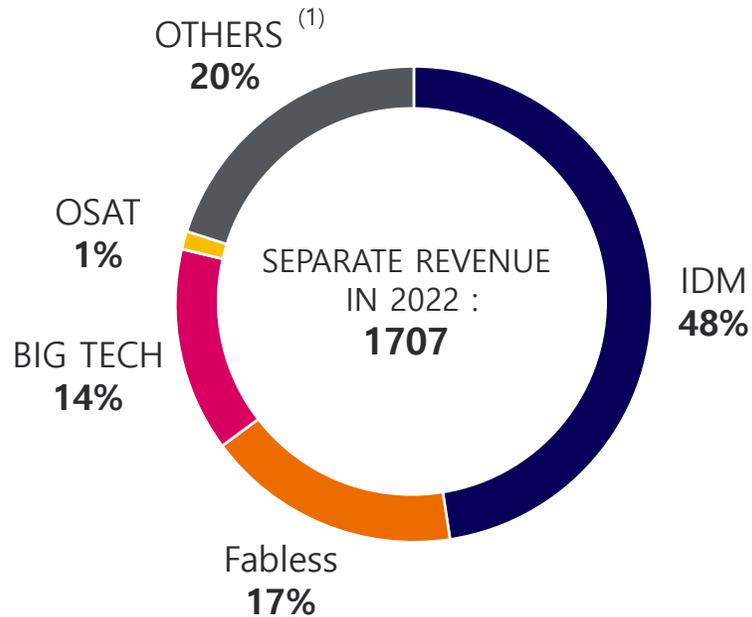
[2019~2022 Non-memory Sales]

“전체 매출의 65~70%가 비메모리 제품군에서 발생 ”

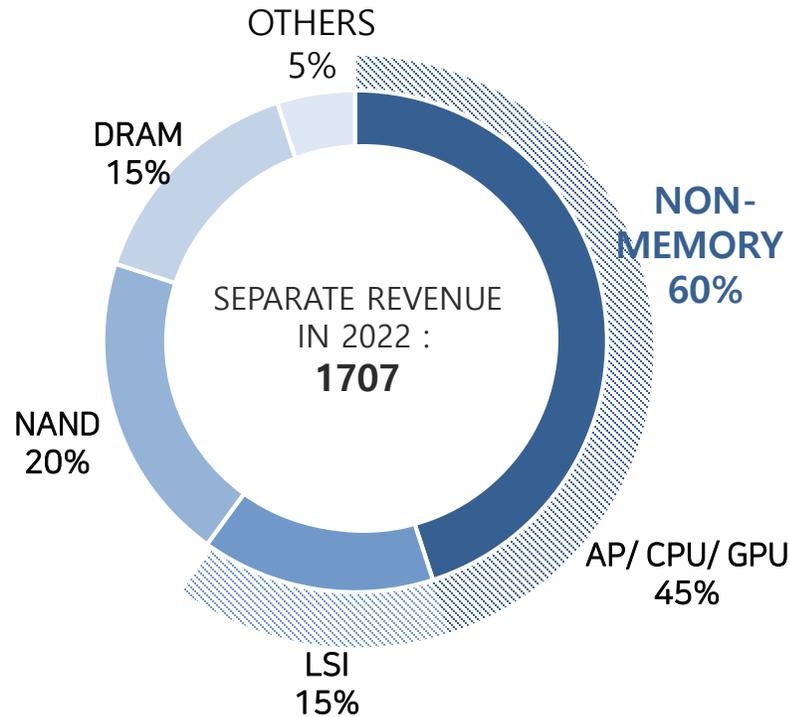


3. ISC 경쟁력 다변화된 고객사와 제품군을 기반으로 한 안정적인 매출 구조

고객군별 매출 비중 (22년) (억원, %)



어플리케이션별 매출 비중 (22년) (억원, %)



10 / 10
TOP 10 global semiconductor companies.



5 / 5
TOP 5 BIG TECH

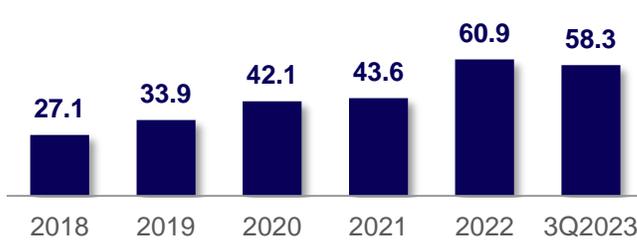


5 / 5
TOP 5 OSAT

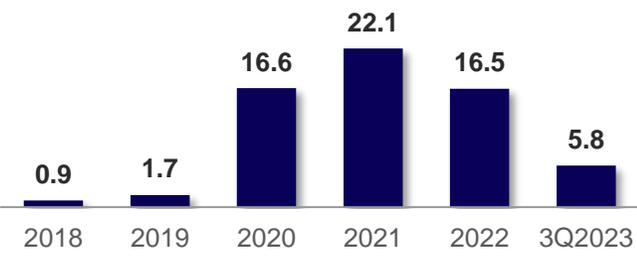
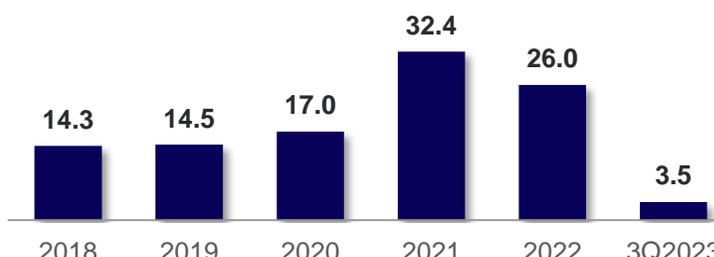
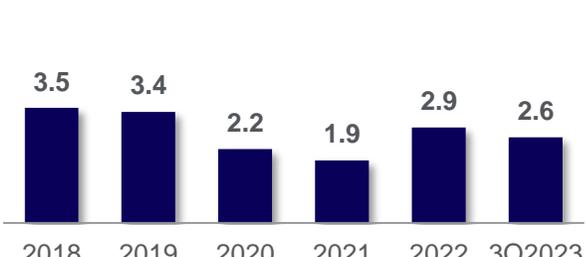


5 / 5
TOP 5 FOUNDRY

4.경영실적 2023 사업아이템별 매출 비중

	Silicone rubber socket		POGO socket / POGO pin																																										
제품 브랜드	 For Non-memory - Mobile AP/CPU/GPU - LSI (CSI, PMIC, RF)	For Memory - Flash (MCP/NAND/SSD) - DRAM (DDR/GDDR/LPDDR)	 Non-memory Mobile SoC ⁽²⁾ , RF chip for autonomous-driving cars etc.																																										
2023 매출비중	50%		25%																																										
매출 동향 (십억원)	 <table border="1"> <tr><th>Year</th><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>3Q2023</td></tr> <tr><th>Sales (Billion KRW)</th><td>27.1</td><td>33.9</td><td>42.1</td><td>43.6</td><td>60.9</td><td>58.3</td></tr> </table>	Year	2018	2019	2020	2021	2022	3Q2023	Sales (Billion KRW)	27.1	33.9	42.1	43.6	60.9	58.3	 <table border="1"> <tr><th>Year</th><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>3Q2023</td></tr> <tr><th>Sales (Billion KRW)</th><td>55.6</td><td>29.1</td><td>31.0</td><td>33.4</td><td>46.0</td><td>29.0</td></tr> </table>	Year	2018	2019	2020	2021	2022	3Q2023	Sales (Billion KRW)	55.6	29.1	31.0	33.4	46.0	29.0	 <table border="1"> <tr><th>Year</th><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>3Q2023</td></tr> <tr><th>Sales (Billion KRW)</th><td>26.3</td><td>7.0</td><td>7.5</td><td>10.7</td><td>19.9</td><td>11.0</td></tr> </table>	Year	2018	2019	2020	2021	2022	3Q2023	Sales (Billion KRW)	26.3	7.0	7.5	10.7	19.9	11.0
Year	2018	2019	2020	2021	2022	3Q2023																																							
Sales (Billion KRW)	27.1	33.9	42.1	43.6	60.9	58.3																																							
Year	2018	2019	2020	2021	2022	3Q2023																																							
Sales (Billion KRW)	55.6	29.1	31.0	33.4	46.0	29.0																																							
Year	2018	2019	2020	2021	2022	3Q2023																																							
Sales (Billion KRW)	26.3	7.0	7.5	10.7	19.9	11.0																																							
주요고객사	Global/Korean IDM, Fabless, Big Tech		Global/Korean IDM																																										

4.경영실적 2023 사업아이템별 매출 비중

	Burn-in Socket	Test Solution	Others																																										
제품 브랜드	 Burn-in Test Socket	   Test Interface Unit ⁽⁵⁾ Connector Temperature Control Device	Others																																										
2023 매출비중	5%	3%	2%																																										
매출 동향 (십억원)	 <table border="1"> <tr><th>Year</th><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>3Q2023</td></tr> <tr><th>Sales (Billion KRW)</th><td>0.9</td><td>1.7</td><td>16.6</td><td>22.1</td><td>16.5</td><td>5.8</td></tr> </table>	Year	2018	2019	2020	2021	2022	3Q2023	Sales (Billion KRW)	0.9	1.7	16.6	22.1	16.5	5.8	 <table border="1"> <tr><th>Year</th><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>3Q2023</td></tr> <tr><th>Sales (Billion KRW)</th><td>14.3</td><td>14.5</td><td>17.0</td><td>32.4</td><td>26.0</td><td>3.5</td></tr> </table>	Year	2018	2019	2020	2021	2022	3Q2023	Sales (Billion KRW)	14.3	14.5	17.0	32.4	26.0	3.5	 <table border="1"> <tr><th>Year</th><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>3Q2023</td></tr> <tr><th>Sales (Billion KRW)</th><td>3.5</td><td>3.4</td><td>2.2</td><td>1.9</td><td>2.9</td><td>2.6</td></tr> </table>	Year	2018	2019	2020	2021	2022	3Q2023	Sales (Billion KRW)	3.5	3.4	2.2	1.9	2.9	2.6
Year	2018	2019	2020	2021	2022	3Q2023																																							
Sales (Billion KRW)	0.9	1.7	16.6	22.1	16.5	5.8																																							
Year	2018	2019	2020	2021	2022	3Q2023																																							
Sales (Billion KRW)	14.3	14.5	17.0	32.4	26.0	3.5																																							
Year	2018	2019	2020	2021	2022	3Q2023																																							
Sales (Billion KRW)	3.5	3.4	2.2	1.9	2.9	2.6																																							
주요고객사	Korean/Global IDM	Korean IDM, OSAT	-																																										

4. 경영실적 2023 3Q 어플리케이션별 매출 비중

	AI/ Data Center / Server	Mobile / Wearable Device	Automotive / Others																																										
제품군	DRAM, LPDDR, GDDR, SoC, CPU, GPU	LPDDR5x, UFS, AP	LPDDR5, LPDDR5x, Automotive SoC																																										
2023 매출비중	50%	40%	10%																																										
매출동향 (십억원)	<table border="1"> <tr><th>Year</th><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>3Q2023</td></tr> <tr><th>Sales (Billion KRW)</th><td>51.8</td><td>42.9</td><td>58.3</td><td>72.0</td><td>85.3</td><td>58.3</td></tr> </table>	Year	2018	2019	2020	2021	2022	3Q2023	Sales (Billion KRW)	51.8	42.9	58.3	72.0	85.3	58.3	<table border="1"> <tr><th>Year</th><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>3Q2023</td></tr> <tr><th>Sales (Billion KRW)</th><td>40.0</td><td>35.0</td><td>48.6</td><td>57.8</td><td>71.5</td><td>46.6</td></tr> </table>	Year	2018	2019	2020	2021	2022	3Q2023	Sales (Billion KRW)	40.0	35.0	48.6	57.8	71.5	46.6	<table border="1"> <tr><th>Year</th><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>3Q2023</td></tr> <tr><th>Sales (Billion KRW)</th><td>10.0</td><td>8.7</td><td>12.1</td><td>14.4</td><td>17.9</td><td>11.6</td></tr> </table>	Year	2018	2019	2020	2021	2022	3Q2023	Sales (Billion KRW)	10.0	8.7	12.1	14.4	17.9	11.6
Year	2018	2019	2020	2021	2022	3Q2023																																							
Sales (Billion KRW)	51.8	42.9	58.3	72.0	85.3	58.3																																							
Year	2018	2019	2020	2021	2022	3Q2023																																							
Sales (Billion KRW)	40.0	35.0	48.6	57.8	71.5	46.6																																							
Year	2018	2019	2020	2021	2022	3Q2023																																							
Sales (Billion KRW)	10.0	8.7	12.1	14.4	17.9	11.6																																							
주요 고객사	Korean /Global IDM , Global Fabless	Korean /Global IDM , OSAT, Big Tech	Korean /Global IDM , End-User, Big Tech																																										

Financial Statement

◆ 재무상태표(연결)

(단위: 억원)

구분	2019	2020	2021	2022	2023 3Q
유동자산	653.8	782.5	983	1,617	1,675
비유동자산	1,429	1,594	1,633	1,966	1,802
자산총계	2,084	2,394	2,617	3,584	3,478
유동부채	250	592	348	813	657
비유동부채	50	75	43	91	95
부채총계	300	667	391	904	753
자본금	70	70	82	86	87
이익잉여금	963	1,020	1,305	1,708	1,719
자본총계	1,784	1,727	2,225	2,680	2,725
자본과 부채총계	2,084	2,394	2,617	3,584	3,478

◆ 포괄 손익계산서(연결)

(단위: 억원)

구분	2019	2020	2021	2022	2023 3Q
매출액	876	1,217	1,446	1,789	1,152.8
매출원가	666	848	818	945	689.5
매출총이익	210	370	628	844	46.3
판매비와 관리비	190	189	253	285	380.5
영업이익	20	181	375	559	82.7
EBITDA	135	269	474	696	171.1
영업외수익	47	87	76	158.4	59.8
영업외비용	34	82	69	95.9	32
법인세차감전순이익	31	101	374	621	154
법인세비용	(1)	46	73	182	38
당기순이익	32	55	301	439	116.4



Total Test Solution Provider ! Global Market Share No.1 Company !!

감사합니다.